

KOMBI RAPID

Klej do płyt styropianowych



GŁÓWNE ZALETY

- Wysoka izolacyjność termiczna (wsp. $\lambda = 0,0348 \text{ W/m}^2\text{K}$), bez ryzyka mostków termicznych
- Niski przyrost objętości i wysoka stabilność wymiarowa
- Wysoka przyczepność i odporność mechaniczna
- Szybki czas wiązania
- Łatwa aplikacja i dobre właściwości robocze

ZASTOSOWANIE

Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz klejenie płyt ze styropianu ekspandowanego (EPS) lub styropianu ekstrudowanego (XPS) do podłoża mineralnych (jak np. beton, ceramika) w systemach **KABE THERM SM** i **KABE THERM SM RENO**, w których płyty izolacji cieplnej są jednocześnie mocowane mechanicznie do podłoża (wg projektu technicznego). Termoizolacja fundamentów, ścian i piwnic (mocowanie płyt styropianowych EPS, XPS do podłoża mineralnych i bitumicznych). Wypełnianie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi, szczelin powstałych na skutek docinania płyt. Dylatacje pionowe w murach. Uszczelnianie złączy, np. przy parapetach, płytkach parapetowych, płytach balkonowych, oknach piwnicznych czy oknach w przyziemi.

DANE TECHNICZNE

Czas otwarty: do 10 minut*
Czas korekty położenia przyklejonej płyty styropianowej: do 10 minut
Czas utwardzenia kleju (przy wilgotności wzgl. powietrza 50% i temp. 23°C): 2 godziny**
Odporność termiczna po utwardzeniu: od +40°C do +90°C
Wydajność: do 8m²* (ocieplanie ścian) oraz do 12m²* (fundamenty, piwnice, przyziemie)
Przyczepność do betonu: $\geq 0,3 \text{ MPa}$
Przyczepność do styropianu: $\geq 0,1 \text{ MPa}$ (zerwanie w masie)
Temperatura otoczenia i podłoża oraz utwardzania kleju: od +1°C do +30°C (zalecana od +10°C do +25°C)

Temperatura puszk: od +5°C do +25°C (optymalnie +20°C)
Warunki aplikacji na zewnątrz budynku: pogoda bezdeszczowa, unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze
Wielkość opakowania: puszka metalowa zawierająca 750 ml kleju
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji podanej na denku puszk.
Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), czyste, odtłuszczone, odpylone i wyrównane. Dopuszczalne odchylenie powierzchni ściany nie może przekroczyć -4 mm i +2 mm (pomiar dokonać łata o dł. 2 m z dokładnością do 1 mm). W przypadku większych nierówności wykonać warstwę wyrównawczą. Fundamenty i ściany oczyścić mechanicznie z zabrudzeń oraz porostu glonów i grzybów, a następnie zmyć wodą i odkażać preparatem **ALGIZID**. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę by na klejonych powierzchniach nie było szronu. Płyty izolacyjne (inaczej niż cięte) mogą zawierać środki antyadhezyjne. Przeprowadzić test przyczepności. W razie potrzeby powierzchnię tylną płyt przeszlifować. Dla zwiększenia przyczepności, przyspieszenia utwardzania i poprawy struktury, podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza.

PRZYGOTOWANIE KLEJU: Bezpośrednio przed użyciem puszkę z klejem bardzo dobrze wymieszać. Nakręcić na pistolet. Początkową partię kleju (ok. 30 cm), aż do wyrównania się ciśnienia w pistolecie skierować na bok nie (do użycia). Przyklejanie płyt zaczynać zawsze od dołu, opierając dolny rząd na listwie startowej lub na stopie fundamentowej. Ewentualne zabrudzenia usuwać przy pomocy specjalnych ściereczek czyszczących lub za pomocą czyścika do piany poliuretanowej. **Uwaga:** Czyścik może wejść w reakcję z płytą styropianową i doprowadzić do jej uszkodzenia. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Miejsca w których klej jest wyeksponowany na działanie promieniowania UV należy zabezpieczyć w ciągu 10 dni od nałożenia kleju. Do ochrony przed promieniowaniem UV stosować zaprawę, silikon lub akryl.

KLEJENIE PŁYT PRZY OCIEPLANIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW: Klej nakładać na płyty po obwodzie z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi płyty oraz pasmem w kształcie litery „M” lub „W”. W ciągu maksymalnie 10 minut od nałożenia kleju płyty należy przyłożyć do podłoża i docisnąć, używając łaty. Korektę równości ułożenia płyt można przeprowadzić maksymalnie do 10 minut od ich przyklejenia. Kołkowanie można rozpocząć po upływie 3 godzin od przyklejenia. Spoina klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość mechaniczną po 24 godzinach od przyklejenia płyt. **Uwaga:** Czas wiązania może ulec wydłużeniu w przypadku występowania niskiej temperatury i niskiej wilgotności powietrza.

KLEJENIE PŁYT PRZY TERMOIZOLACJI FUNDAMENTÓW, ŚCIAN PIWNIC I TYM PODOBNYCH PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW: Klej nakładać jednostronnie na podłoże pionowymi paskami z zachowaniem odstępów 20–30 cm. W przypadku płyt o szer. 150–160 cm, należy nałożyć przynajmniej 5 pasków. Płyty przyłożyć do podłoża po ok. 10 minutach od nałożeniu kleju, a następnie docisnąć. Pozostałe szczeliny i złącza między płytami podobnie wypełnić klejem.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Przy termoizolacji podziemnych części budynków klej można stosować wyłącznie w systemach hydroizolacji lekkiej przeciwwilgociowej – przeprowadzić test przyczepności. Nie stosować w przypadku ciągłej ekspozycji na działanie wody np. zanurzenie spowodowane wysokim poziomem zwierciadła wód gruntowych – hydroizolacja ciężka lub przeciwwodna. Nie stosować do klejenia PE, PP, tefonu, powierzchni silikonowych, pokrytych środkami poszlizgowymi, nawilżającymi (membrany z filmem PE). Nie stosować do podłoża hydroizolowanych za pomocą bitumicznych wyrobów rozpuszczalnikowych – ryzyko uszkodzenia płyt (zapoznać się dokładnie z instrukcją wyrobu i sprawdzić czy producent przewiduje możliwość klejenia płyt styropianowych). Płyty można kleić po całkowitym wyschnięciu powłok hydroizolacyjnych – zapoznać się z instrukcją wyrobu. Nie stosować podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru czy przy silnym nasłonecznieniu.

* czas otwarty oraz wydajność zależą w dużym stopniu od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz podłoża, temperatury puszk, sposobu zastosowania, przekroju nałożonej warstwy, zwilżenia podłoża itp.

** czas utwardzania jest uzależniony od warunków atmosferycznych.